

乐泰3536-BGA底部填充胶

产品名称	乐泰3536-BGA底部填充胶
公司名称	中山市沃瑞森电子科技有限公司
价格	320.00/支
规格参数	品牌:汉高 型号:3536
公司地址	深圳市福永镇兴中宝商厦9010室（深圳办事处） /广东省中山市兴华街79号
联系电话	0755-27399350 13509635281

产品详情

loctite 3536芯片级封装和bga底部填充剂

填料：环氧树脂

颜色：黑色液体

黏度：1800 mpa.s

工作时间：25 14天以上

保存条件：2~8 6个月

固化条件：120 固化5分钟/130 固化2分钟

包装：30ml/支 500ml/支

应用：芯片级封装和bga底部填充剂，用于在低温时快速固化。

固化后可有效保护焊接接头防止其受到冲击，跌落和振动等机械应力。